

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	中金公司 郭威秀 华泰证券 詹寿明 国泰君安 马潇 恒盈资本 王凯纳 源乘投资 彭晴 尚诚资产 黄向前 尚诚资产 杜新正 趣时资产 投资人
时间	2023年6月7日（星期三）上午 10:00 至 11:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>劲拓股份(300400)是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，均位于深圳市宝安区，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，欢迎广大投资者到公司实地参观。</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <p>公司专用设备业务可分为三类：电子装联设备（电子热工设备及配套设备）、半导体专用设备、光电显示设备。</p> <p>1、公司设立以来持续深耕电子热工相关领域，被行业协会授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证、全球市场占有率领先。这块业务是公司领先优势业务，也是公司的基本盘。</p> <p>2、公司随后约于2017年布局光电显示业务，产品突破海外技术封锁，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制程，得到京东方等国产面板厂商和大型模组厂的认可并实现长期深度合作。</p> <p>3、公司自2021年起布局半导体专用设备业务，目前系公司重点发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无</p>

投资者关系活动主要内容介绍

尘压力烤箱等多款半导体热工设备、硅片制造设备，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。2022 年为半导体专用设备规模化销售元年，相关设备产品累计交付服务客户超过 20 家，获得客户的认可、验收及复购。公司高度重视半导体专用设备业务的发展，不仅制定了明确的业绩考核要求，在各类资源投入方面也有所侧重。

（三）公司的核心竞争力

公司的核心竞争力主要体现在产品力方面。电子装联业务系公司的优势业务和基本盘，技术实力、产品质量、市场份额和品牌知名度得到广泛认可，一直走在行业前列。半导体专用设备业务方面，公司研发生产了多款国产空白的半导体热工设备、硅片制造设备并逐渐打开市场，获得半导体行业客户的认可和复购，奠定了半导体专用设备业务长足发展的基础。公司光电显示设备作为突破技术封锁的国产替代产品销售给全球显示巨头企业，获得下游核心客户的认可并长期深度合作。

客户方面，公司拥有一批稳定优质的客户群体，累计服务客户 4,000 余家，其中半导体专用设备交付客户 20 余家；凭借多年来优质的产品和服务，在业内积累了良好的口碑和声誉，体现了公司的软实力。

研发方面，公司多年来坚持自主研发创新，多款设备打破国外技术垄断，在热工学温度控制、OLED 屏幕贴合等方面形成了具有自主知识产权的核心技术；建立了较完善的研发体系，能够不断复制成功经验和领先优势，技术延展和突破能力强。

此外，公司在高效的营销服务体系、强大的生产交付能力等方面具有领先优势，而稳健良好的财务基础、充裕的现金流为公司应对外部环境变化、持续开展研发攻关提供了有力保障。

（四）公司的经营情况

2022 年度，公司实现营业总收入 79,117.78 万元，主要受宏观环境不利因素影响有所波动；实现归属于上市公司股东的净利润 8,910.33 万元，较上年同期上升 11.41%；经营性现金流质量良好，实现经营性现金流量净额 12,906.49 万元。

2023 年第一季度，公司实现营业收入 14,227.26 万元，较上年同期上升 9.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 264.99 万元，主要受到研发费用增加等因素影响，较上年同期有所下降。往年的分季度经营成果数据显示，一季度往往是相对淡季，公司将在半年度报告中披露 2023 年上半年经营业绩，敬请投资者关注后续披露信息。

二、问答交流

1、公司半导体专用设备主要有哪些？客户主要有哪些？请展望公司半导体业务的发展？

投资者关系活动主要内容介绍

回复：（1）公司半导体专用设备包括半导体热工设备和硅片制造设备，半导体热工设备是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备，半导体硅片制造设备则用于半导体硅片生产过程，包含半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等；在技术和性能方面对标美国、德国等国的一些技术和产品成熟度较高的企业，同时具备价格、交期、售后服务等方面的优势，具有较强的进口替代实力。

（2）公司的半导体专用设备已累计交付 20 余家半导体行业客户，产品得到验收及复购，正在陆续接洽意向客户和潜在客户并取得积极进展。

（3）公司除面向下游大型封测厂商、硅片制造厂商持续开展客户拓展、推进产品验证之外，还进一步丰富产品线、满足客户不同需求。公司在股权激励中以半导体专用设备业务增速为重要考核目标，并将积极寻求包含对外投资在内的方式多措并举地整合产业链资源，有决心、有信心推动半导体专用设备业务的持续高质量发展。

2、公司研发人员规划如何？

回复：公司专用设备业务属于技术和人才密集型业务，产品创新有赖于优秀的研发人才。公司设立了研究院，在子公司层面也有专门的研发团队，分别负责研发体系搭建、推进产学研合作、技术延展和产品开发、产品定型等工作。

公司高度重视研发团队管理，以自我培育与外部引进相结合的方式组建人才团队；在“以人为本”的管理模式、良好的工作环境体验基础上，公司针对研发人员建立了适合研发体系和管理模式的薪酬绩效考核机制，开展股权激励、员工持股以及在子公司层面进行技术人员持股等，在人才选育留用和考核激励方面下功夫。

公司 2023 年第一季度研发费用为 1,223.34 万元，受到研发人员增加等因素影响同比上升 74.96%。公司始终重视研发创新，2023 年将继续攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体专用设备，推动产品拓展、性能提升、研发成果转化；同时优化和提升电子装联设备、光电显示设备性能，提高产品技术壁垒。

3、2023 年度电子装联业务的景气度如何？

回复：电子装联业务系公司成立以来一直深耕的业务，也是目前占营业收入比重最大的业务。公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，与国际品牌竞争，应用终端行业十分广泛，涵盖通讯电子、汽车电子、消费电子、航空航天电子等，单一细分市场的波动往往对公司业务影响不大。随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力，公司

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>电子整机装联业务的优势得以体现。伴随着电子制造产业链全球分工调整，公司也积极推动品牌更好地走向国际，加强对海外市场布局、拓展订单来源。公司对电子整机装联业务的持续高质量发展充满信心。</p> <p>4、能否拆分一下 2022 年度电子装联业务中细分领域的营收同比增速、盈利能力区别？</p> <p>回复：公司电子装联设备包括电子热工设备、检测设备和自动化设备，覆盖电子产品 PCBA 生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程，为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统，主要提供给下游电子制造企业，用来组建电子工业中的 PCBA 生产线，该类设备能够广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、航空航天、其他电子产品的生产过程。</p> <p>2022 年度，电子装联设备中大约 5.9 亿元收入为电子热工设备，主要受到宏观环境不利因素影响同比有波动；自动化设备收入 2,424 万元、检测设备收入 5,313 万元，该两类设备主要为电子热工设备配套使用，便于客户一站式采购，销售规模占比不大。从毛利率方面来看，电子热工设备、检测设备的毛利率高于自动化设备。</p> <p>5、公司回流焊是制造业单项冠军，这块的市场空间和竞争格局如何衡量？</p> <p>回复：公司系国内电子热工领域的龙头企业，市场占有率领先，竞争对手主要为美国、德国的品牌企业。</p> <p>公司会积极把握全球市场的存量更新和新增需求机会，力争继续提高产品市场占有率。2023 年伴随着电子制造产业链全球分工调整，公司也积极推动品牌更好地走向国际，加强对海外市场布局、拓展订单来源。</p> <p>6、2022 年前五大客户分别是哪些？涉及哪些行业？前五大客户变动情况如何？</p> <p>回复：公司设备产品广泛应用于各类电子产品 PCBA 制程、芯片封装、显示模组制程等，终端应用领域较多、客户储备丰富。在电子装联业务方面，公司与国内许多大型电子制造企业、上市公司长期合作，如近年位列前五大客户的富士康等；光电显示业务方面，公司与国内显示模组龙头企业京东方长年深度合作、客户均为行业内大型优质企业，2022 年度京东方也在前五大客户之列。半导体专用设备业务方面，公司产品面向大型封测厂商、硅片制造企业，迄今交付客户累计超过 20 家，包含一些大型上市企业；半导体专用设备 2022 年首度规模化销售，当前体量下暂未有客户列入前五大范围。</p> <p>从变动情况来看，前五大客户同比变动不大。公司将持续推进战略级业务发展，同时夯实领先优势业务的市场竞争力，为广大工业企业提供优质的</p>
----------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>设备应用体验。</p> <p>7、公司海外市场开拓情况如何？</p> <p>回复：公司产品一直有部分出口，2022 年总体出口销售规模占比为 6.71%。目前全球相关产业链分工调整带来部分海外市场机遇，公司已陆续接到有关订单，公司将多措并举地增强在海外市场的竞争力、为境外客户提供良好的服务体验。</p> <p>8、公司控股股东、实际控制人吴限先生拟委托公司表决权事项预计什么时候完成？吴限先生现在还在公司担任职务吗？控制权变更后国资委调整公司的高层人员架构吗？</p> <p>回复：（1）公司控股股东、实际控制人吴限先生筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳经鸿伟畅”）委托其所持公司 27.9%表决权，该事项可能导致公司控制权变更。</p> <p>吴限先生拟委托其表决权事项目前处于意向阶段，公司于 2023 年 1 月 30 日披露了双方《表决权委托意向协议》有关内容，同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至以下三个时点中较早之日止：①委托方、受托方签署《表决权委托协议》且协议生效之日；②委托方、受托方签署《表决权委托意向协议之终止协议》且协议生效之日；③2023 年 12 月 31 日。</p> <p>公司本次控制权变更相关事项尚存在不确定性，针对该事项进展情况，公司将在获知有关进展后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，谨慎决策、注意投资风险。</p> <p>（2）吴限先生是公司的创始人，目前在公司任职，不担任公司治理层、高级管理职务。</p> <p>（3）根据已签署的《表决权委托意向协议》及补充协议，双方暂未就表决权委托生效后公司董事会席位安排、管理层任免、生产经营决策等进行安排。</p> <p>9、公司董事长变更的原因和背景是什么？</p> <p>回复：公司搭建了完善的治理结构，主要经营管理人员各司其职，围绕公司既定战略目标协同工作。</p> <p>原董事长徐德勇先生作为公司总经理、子公司深圳市思立康技术有限公司董事长，为更好地专注于半导体专用设备业务发展，向董事会申请辞去董事长职务，辞职后继续担任董事、审计委员会委员、总经理职务。徐德勇先生有着丰富的主营业务相关经营管理经验，公司由总经理全面负责日常经营管理活动、总经理系公司法定代表人。</p>
----------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>现任董事长王新杰先生有着丰富的实业、投融资领域管理经验，根据《公司章程》规定履行董事长职责，能够组织董事会协同高效运作，带领董事会围绕未来发展战略推动 2023 年度经营计划落地。</p> <p>10、深圳市劲彤投资有限公司这一子公司主要实施哪些投资业务？</p> <p>回复：劲彤投资系公司实施对外投资的平台，目前已投资控股了主营半导体专用设备业务的深圳市思立康技术有限公司、深圳至元精密设备有限公司，参投了深圳市中经彤智企业管理有限公司等。公司设立劲彤投资有利于集中进行对外投资的专业决策和投后管理，其不涉及高风险投资或二级市场股票投资。</p> <p>11、除劲彤投资外，公司其他主要下属公司定位是什么？</p> <p>回复：深圳市思立康技术有限公司由总经理徐德勇先生担任董事长，主营半导体封测专用设备业务。深圳至元精密设备有限公司主要做半导体硅片制造设备业务。公司主要子公司在公司统筹管理之下，具有一定的经营自主权，同时实施经营管理团队持股，在保障合法合规经营运作的基础上，提高了经营效率、强化了管理团队主人翁意识和责任感。</p> <p>12、从今年目前的情况来看，公司股权激励计划业绩考核目标预期达成情况如何？</p> <p>回复：公司股权激励计划业绩考核以营业总收入及半导体专用设备营业收入为考核指标，具体业绩考核目标达成情况及公司经营成果数据敬请关注后续于巨潮资讯网披露的各项公告。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 6 月 7 日</p>